

# 芯原微电子（上海）股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“芯原”）致力于提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，切实履行上市公司的责任和义务，进一步提升公司经营效率，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。现将进展情况公告如下：

### 一、聚焦主营业务，提升科技创新能力

#### （一）技术研发

自公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司持续推进核心技术的研发迭代，以保持技术先进性和核心竞争力，并始终关注市场趋势和技术发展动向，针对目标和关键市场，积极开展新技术的研发，进一步提升公司的科技创新能力和核心竞争力。

##### 1、持续升级技术研发，提升核心竞争力，深化行业头部客户合作

2024 年，公司根据自身的技术、资源、客户积累，并结合市场发展趋势，已逐步在 AIGC、数据中心、汽车电子和可穿戴设备这 4 个领域形成了一系列优秀的 IP、IP 子系统及平台级芯片定制解决方案。例如：

- 针对日益增长的支撑 AIGC 应用的海量算力需求，公司推出了面向高性能计算的 AI GPU IP、高性能 GPU IP 和 GPGPU IP 等，极大地丰富了公司的 AI 计算技术储备，以满足更广泛的人工智能计算需求；针对 AIGC 对端侧入口设备的需求，公司还推出了超轻量实时在线终端平台解决方案。此外，针对 AIGC 产

业所面临的安全性和隐私性等问题，公司还继续深化与谷歌合作的开源项目 Open Se Cura，针对安全、可扩展、透明和高效的人工智能系统的发展，公司提供了多款平台级解决方案，支持超低功耗空间计算，并提供优质、高效的 AIGC 输入 (Token)，并持续推动该项目的商业化。

- 2024 年，公司推出了全新的 VC9800 系列高性能视频处理器 IP，面向视频转码服务器、AI 服务器、云桌面和云游戏等在内的下一代数据中心的先进需求，以增强的视频处理性能，进一步提升公司在数据中心应用领域的市场地位。

- 针对高性能汽车应用，公司的图像信号处理器 IP ISP8200-FS 和 ISP8200L-FS 通过了汽车功能安全标准 ISO 26262 认证，达到随机故障安全等级 ASILB 级和系统性故障安全等级 ASILD 级。在自动驾驶领域，公司还推出了功能安全 SoC 平台的总体设计流程、ADAS 功能安全方案和自动驾驶软件平台，并为某知名新能源汽车厂商提供基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片的一站式定制服务，其中集成了芯原的多个半导体 IP，性能全球领先。目前公司正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作，以在智慧出行领域取得更好的发展机会。

- 在可穿戴领域，公司正在通过与趣戴科技等生态系统伙伴的合作，积极拓展基于芯原 GPU 的全球手表 GUI 生态系统，从而扩大客户群，促进更多样化的智能手表应用的开发。此外，公司还正在与多家全球领先的 AR/VR 客户开展多个项目的合作。

凭借延伸至软件及系统解决方案的平台化服务能力，以及长期服务世界一流客户群体的经验基础和口碑，公司巩固其作为系统厂商、互联网公司和云服务提供商首选的芯片设计服务合作伙伴的地位。对于现有重要行业头部客户，公司通过持续的客户产品迭代升级、为同一客户的不同部门/产品线提供多样化的服务等方式，巩固和深化合作；同时，公司积极开拓优质行业头部客户，通过双方的深度合作重点布局 AIGC、汽车、数据中心、智慧可穿戴、智慧物联网等行业应用领域，从而保持公司的市场敏锐度，以及业务与技术的领先性，成为头部客户重要的战略合作伙伴。

2、深度布局高性能计算和异构计算，推进 Chiplet 技术及产业化，实现竞争

## 力升维

作为全球领先的一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务供应商，Chiplet 技术迭代研发及产业化落地是芯原发展的核心战略之一。芯原是中国首批加入 UCIE 产业联盟的企业之一，公司正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。上述举措将提高公司的 IP 复用性，增强业务间协同，增加设计服务的附加值，拓宽业务市场空间；进一步降低客户的设计时间、成本和风险，提高芯原的服务质量和效率，更深度绑定客户；并进一步提高公司盈利能力，实现竞争力升维。此外，公司拟通过实施向特定对象发行股票中募投项目“AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目”，以加速推进公司 Chiplet 技术迭代研发及产业化发展战略的落地。

## （二）人才培养

公司基于战略考虑坚持引进和储备优秀人才。集成电路设计行业为典型的人才密集型行业，且人员具有一定的培养周期，公司也将在持续优化迭代现有核心技术的基础上，进一步就 AIGC、汽车、数据中心、智慧可穿戴、智慧物联网这几个关键应用领域进行人才培养、储备和激励。截至 2024 年 6 月末，公司拥有研发人员 1,640 人，占比高达 89.18%，硕士及以上文凭的研发人员占比达 87.74%，中国大陆地区具有十年以上工龄的研发人员占比为 28.82%，员工平均年龄为 33.11 岁。

2023 年全行业面临严峻挑战，应届毕业生就业形式不容乐观，公司通过合理的薪酬吸纳优秀毕业生，为未来的技术研发储备人才。2023 年公司招聘的 500 多名应届毕业生，均拥有硕士及以上学历，其中硕士 985、211 院校占比 94%，硕士 985 院校占比 70%。2024 年招聘的 200 多名应届毕业生中，硕士 985、211 的占比为 97%，其中本硕都是 985、211 的占比 85%，这批毕业生将会在未来三年成长为芯原的技术骨干。得益于公司优异的招聘质量和高效的培训机制，去年招聘的应届毕业生已完成内部培训并对今年已经展开和正要承接的多个芯片大

项目提供了必要的人力资源。未来随着行业逐步复苏，公司项目数量增加，这批研发人员将在各自岗位上发挥关键作用。

### **(三) 资源整合**

作为集成电路设计企业和制造企业之间的桥梁，在整个产业链中具有重要的沟通和衔接作用，因为对整个产业链的全局发展有着较为全面的认知。公司积极推动产业的生态建设，2024 年度，公司组织并承办了多个行业论坛及研讨会，包括：

- 第十三届芯原 CEO 论坛：以“AGI 新机遇”为主题，共邀请了 38 位来自芯片设计、系统设计、研究机构、投资机构等相关产业链的决策者出席，会议就“AI 大模型和算力”和“AGI 应用场景”两个话题展开了深入讨论；

- 2024 松山湖中国 IC 创新高峰论坛：公司作为主办方之一，联合中国半导体行业协会集成电路设计分会等创办了松山湖论坛，旨在打造全国最具影响力的创新 IC 推广平台。本届会议重点推广了 10 款代表中国先进 IC 设计水平，与“智慧机器人”应用需求紧密结合的 IC 新品；

- “链聚浦东·芯启未来”RISC-V 产业技术研讨会暨 RISC-V 专利导航成果发布会：本次会议由上海市浦东新区科技和经济委员会指导，公司和上海开放处理器产业创新中心(筹)共同主办，中国 RISC-V 产业联盟(CRVIC)、RISC-V 专利联盟(RVIA)和上海市集成电路行业协会 RISC-V 专委会等单位和机构协办。会议旨在交流 RISC-V 产业发展情况，分享 RISC-V 产业专利导航的最新成果，推动 RISC-V 生态的繁荣健康发展；

- 从云到端，AI 触手可及-芯原 AI 专题技术研讨会：聚焦大模型时代 AI 技术从云端到边缘端的最新发展趋势，来自乌镇智库、南京蓝洋智能科技有限公司、神顶科技（南京）有限公司、电子科技大学等产学研界的嘉宾，与芯原一同探讨大模型在边缘端部署的机遇、挑战和实践案例，以及集成电路如何布局 AI 应用的长远发展；

- “智”由“芯”生——RISC-V 和生成式 AI 论坛：由公司和上海开放处理器产业创新中心联合主办的“‘智’由‘芯’生——RISC-V 和生成式 AI 论坛”

于 2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC 2024）同期在上海世博中心举办，深入探讨了 RISC-V 与生成式 AI 融合发展的技术趋势、市场机遇，并就前沿技术及应用案例进行了分享。

## 二、优化运营效率

2024 年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司经营情况快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善。

公司持续深化与各领域头部企业的合作广度与深度，基于芯原的半导体 IP、芯片定制硬件、软件平台的技术赋能能力，持续提升芯原在相关领域中的地位与价值。2024 年 1-6 月，公司半导体 IP 授权服务新增客户数量 16 家，截至 2024 年 6 月末累计半导体 IP 授权服务客户总数量约 430 家；一站式芯片定制服务新增客户数量 4 家，截至 2024 年 6 月末累计一站式芯片定制服务客户总数量约 325 家。公司近期新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位，截至 2024 年 6 月末在手订单 22.71 亿元，预计一年内转化的比例约为 81%，为公司未来营业收入增长提供了有力的保障。

公司高度重视业务和市场发展绩效，持续坚定拓展目标市场，履行国际化发展战略，2024 年上半年，公司来源于境外的收入金额为 3.29 亿元，占公司营业收入总额的 35.28%。

自公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司持续优化研发、存货、应收账款、资金等事项的运营管理，定期与管理层就上述重点运营事项汇报讨论，以增加运营效率。未来，公司仍将重点加强应收账款情况的实时监控、逾期催收等工作，进一步提高回款速度，持续提升公司经营效率以及资金效率。

## 三、稳步推动再融资项目

2023 年 12 月，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过 2023 年度

向特定对象发行股票事项（以下简称“再融资”），拟募集不超过 180,815.69 万元（含本数），募集资金投资投向为“AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目”和“面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目”。

自公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司再融资项目稳步推进，相关申请已于 2024 年 2 月获得上海证券交易所受理，目前公司已完成首轮问询问题回复。

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，是在公司现有业务与技术成果的基础上的升级与扩充，将为公司实现中长期战略发展目标奠定坚实的基础。通过再融资募投项目的实施，公司将进一步丰富公司技术矩阵、提升产品性能、完善下游应用市场布局、探索前沿技术研究，以满足公司研发布局与业务扩张需求，持续强化公司的科创实力。

## 四、完善公司治理结构

自公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司不断健全公司治理结构，对内控体系进行完善，完成了项目立项流程优化等工作，提升公司治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

公司董监高积极参与了监管机构和行业协会举办的上市公司可持续发展报告（ESG）专题培训（第二期）、上市公司高质量发展系列培训并购重组专题（集成电路专场）、2024 年度独立董事制度改革专题培训等多项培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，推动公司持续规范运作。

公司严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。基于智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目的实施安排，该项目已于 2024 年 6 月完成并结项。

## 五、加强与投资者的沟通

公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司于 2024 年 4 月 1 日公司在上证路演中心平台召开了 2023 年年度报告业绩说明会，并将于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年半年度业绩说明会。公司 2024 年

内已举办了 14 场投资者关系活动，完成 28 个“上证 e 互动”平台问题回复，并参加了上交所主办的走进上市公司活动，通过各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。此外，公司于 2024 年 3 月 30 日发布了《2023 年社会责任报告》，向社会公众及投资人全面展示公司积极履行 ESG 管治的责任和义务，在社会责任、员工关怀等方面的表现，有助于市场更充分的了解公司经营和发展情况。

## 六、完善投资者回报机制

公司将持续根据公司于 2023 年 12 月制定并披露的《未来三年(2023 年-2025 年) 股东回报规划》，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司未来战略发展目标，结合公司经营情况与发展规划，严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制。

## 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束并强化“关键少数”的责任

### （一）强化股权激励及相关约束

自公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司于 2024 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案，同意公司按照本激励计划的相关规定办理预留授予第一批次的限制性股票第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 53 名，可归属的限制性股票数量为 7.4750 万股。此外，同意公司本次拟对 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划项下合计 146.0150 万股已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。上述归属安排及作废事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，并严格按照相关股权激励计划执行。

具体内容详见 2024 年 8 月 9 日公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

披露的《2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-033）、《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

## （二）管理层承诺不减持

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护资本市场的稳定，切实保护全体股东利益，公司董事长兼总裁 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生，董事、副总裁 Wei-Jin Dai（戴伟进）先生，董事、副总裁、首席财务官、董事会秘书施文茜女士，副总裁汪洋先生，副总裁汪志伟先生，副总裁 Martyn Humphries 先生自愿承诺自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内不减持上述其所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份。

公司管理层严格遵守自愿承诺，上述期间内未减持其所持有的公司股份。

## 八、其他措施

综上所述，报告期内，公司严格执行此前制定的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并取得了一定进展。公司将持续对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的具体措施进行评估，并及时履行信息披露义务。未来，公司将进一步提升经营管理水平，继续深耕主营业务，强化核心竞争力，巩固市场地位，优化盈利结构；公司管理层也将一如既往地致力于提升公司业绩和 market 价值，为股东创造更多的投资回报。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日